

## Programm

8.45 Uhr	Begrüßung
09:00Uhr	Hr. Dr. Bell Moderation
09.10 Uhr	<b>NCAB</b> Hr. Zimmermann, Leiterplatten <b>Cost Driver – Kostentreiber in der Leiterplatte</b>
09.35 Uhr	<b>Christian Koenen GmbH</b> Hr. Breer, Schablonen <b>Herausforderungen im Schablonendruck</b>
10.00 Uhr	<b>EKRA GmbH</b> Hr. Vegelahn, Schablonendruck <b>Drucken in neuen „Spheren“</b>
10.25 Uhr	Pause
10.40 Uhr	<b>Juki</b> Hr. Kempf Bestückung <b>Gewinnbringende Optimierungen in der Fertigung bei Steigerung von Quantität und Qualität</b>
11.05 Uhr	<b>Rehm Thermal Systems GmbH</b> Hr. Hanke, SMD- Lötten / Coating
11.30 Uhr	<b>Koh Young GmbH</b> Hr. Eppinger, AOI-Inspektion <b>Spezialisierung in der Elektronikfertigung – Fluch und Segen</b>
11.55 Uhr	Pause
12.10 Uhr	<b>Asys GmbH</b> Hr. Nothjunge, <b>Traceabilitylösungen</b>
12.35 Uhr	<b>TU Dresden</b> Hr. Dr. Wohlrabe <b>Einflüsse von Verwindungen und Wölbungen während des Lötprozesses auf die Qualität von Lötstellen</b>
13.00 Uhr	Lunch
13.45 Uhr	<b>Ersa GmbH</b> Hr. Friedrich, Selektivlöten <b>Design for ... Selektivlöten</b>
14.10 Uhr	<b>Fraunhofer ISIT</b> Helge Schimanski <b>Qualitätsgesicherte Elektronikfertigung durch fortschrittliche Fehleranalyse</b>
14.35 Uhr	<b>Diskussionen mit allen Partnerfirmen</b>
15.00 Uhr	Ende der Vortragsreihe
15.30 Uhr	Beginn Betriebsbesichtigung
19.00 Uhr	Abendveranstaltung in Blaubeuren-Seissen